

产业技术进步

上海IC产业集群“协同学习”实现途径的实证研究

于丽英¹, 窦义粟², 于英川¹

1.上海大学 管理学院; 2.上海投资咨询公司, 上海 200072

收稿日期 修回日期 网络版发布日期 接受日期

摘要 以上海IC集成电路产业集群为研究对象, 通过设计问卷和实地调研, 对上海IC产业集群的主要结构特征进行了分析。在此基础上, 提出了上海IC产业集群协同学习实现途径的6条假设。通过对调查问卷进行数据分析, 揭示了该集群协同学习的5大实现途径: 企业合作、非正式交流、中介服务、产学研合作和政府扶持。

关键词 [集成电路](#) [产业集群](#) [途径](#) [实证研究](#) [上海IC产业](#)

分类号

DOI:

对应的英文版文章: [2009-03-017](#)

通讯作者:

于丽英

作者个人主页: 于丽英¹; 窦义粟²; 于英川¹

扩展功能

本文信息

- ▶ [Supporting info](#)
- ▶ [\[PDF全文\]\(938KB\)](#)
- ▶ [\[HTML\]\(0KB\)](#)
- ▶ [参考文献\[PDF\]](#)
- ▶ [参考文献](#)

服务与反馈

- ▶ [把本文推荐给朋友](#)
- ▶ [加入我的书架](#)
- ▶ [加入引用管理器](#)
- ▶ [引用本文](#)
- ▶ [Email Alert](#)
- ▶ [文章反馈](#)
- ▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

- ▶ [本刊中 包含“集成电路”的 相关文章](#)
- ▶ 本文作者相关文章
 - [于丽英](#)
 - [窦义粟](#)
 - [于英川](#)

